

モノづくりの上流から下流までトータルでご提案いたします

東大阪医工連携ネットワーク

企画・提案

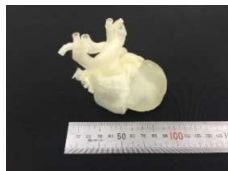
デザイン

設計

試作

少量生産

量産



- 製作提案
- 工法提案

- スケッチ
- クレイモデル作成
- デザインモデル作成

- 機構設計
- 3Dデータ作成
- 3Dスキャン
- ワーキングモデル作成

- 樹脂切削
- 軽金属切削
- 真空注型
- 表面処理
- 3Dプリンタ

- 真空注型
- 簡易金型
- 3Dプリンタ
- 塗装
- 蒸着
- シルク印刷



- 形状提案
- 機能提案
- 機構提案

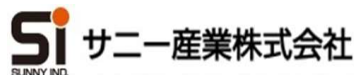
- イメージスケッチ

- 機構設計
- 機能設計
- 製品3Dデータ作成
- フォーミング金型設計

- プレス加工
- マルチフォーミング
- ワイヤーフォーミング
- コイリング加工
- 微細加工

- プレス加工
- マルチフォーミング
- ワイヤーフォーミング
- コイリング加工
- 微細加工
- 組立・アッセンブリー

- プレス加工
- マルチフォーミング
- ワイヤーフォーミング
- コイリング加工
- 組立・アッセンブリー



- 商品企画提案

- スケッチ
- 3Dデータ作成

- 機構提案
- 機構設計
- 製品3Dデータ作成
- 金型設計
- 治具設計

- 樹脂切削
- 射出成形
- 塗装 ●蒸着
- 印刷 (パッド・シルク他)
- 超音波溶着
- 熱圧着 ●組立

- 射出成形
- 切削加工
- 塗装 ●蒸着
- 印刷 (パッド・シルク他)
- 超音波溶着
- 熱圧着 ●組立
- 治具製作

- 射出成形
- 切削加工
- 塗装 ●蒸着
- 印刷 (パッド・シルク他)
- 超音波溶着
- 熱圧着 ●組立
- 治具製作



- 医療機器 商品企画サポート
- 市場動向調査
- 開発計画

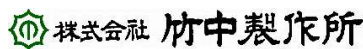
- 市場要求仕様書、製品要求仕様書の作成
- デザインモデルの提案
- 構想設計

- 設計 (メカ・電気)
- 組込ソフト (マイコン・PCアプリ)
- PLCソフト
- 基板回路設計
- 薬事申請資料作成
- 開発ドキュメント作成

- 要素試作
- 機能モデル
- 設計検証
- 妥当性確認

- 試作・開発から製造への移管
- 部品調達 (基板・金型品)
- ISO13485に基づく品質管理
- 出荷検査
- クリーンルーム

- 試作・開発から製造への移管
- 部品調達 (基板・金型品)
- ISO13485に基づく品質管理
- 出荷検査
- クリーンルーム



- パワエレ開発の製品化テーマへの具現化支援提案

- 電源基盤AW設計
- パワエレ機器構造設計
- インフラ向け機器の耐環境設計

- 専用治具の設計
- グラフト高分子の設計
- 電源基板回路設計
- アナログ、デジタル制御基板回路設計
- FPGA, ソフトウェア設計

- 治具製作
- 特殊表面処理加工
- 性能確認試験
- グラフト高分子の合成
- 超音波分散
- 分散性評価
- TEM等による分散性評価
- 電源性能評価用試作
- 各種実験検証用電源機器試作

- 特殊表面処理加工
- 性能確認試験
- グラフト高分子の合成
- 超音波分散
- 分散性評価
- 電源、制御装置の要求仕様に順守した各種評価試験

- 特殊表面処理加工
- 性能確認試験
- グラフト高分子の合成
- 超音波分散
- 分散性評価
- 各種電源試験用機器による評価試験

- 表面処理関係
- 電子機器関係